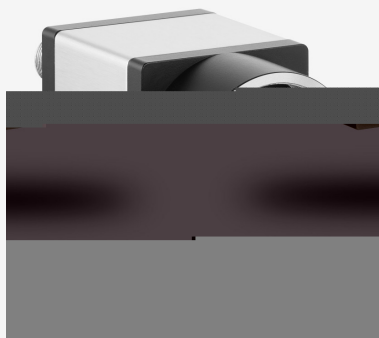


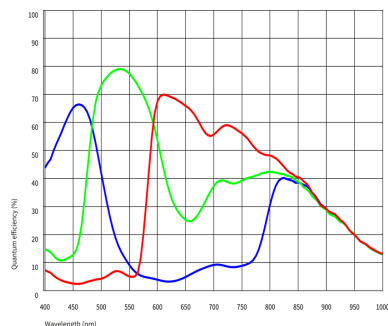
■ 量産中
このカメラモデルは量産中で長期にわたりご使用いただけます。



仕様

センサー

センサーのタイプ	CMOS カラー
シャッター	グローバルシャッター
特性	リニア
解像度/ピクセル	3 MP
有効画素数	3.20 メガピクセル
有効画素数 (h x v)	2064 x 1552 ピクセル
アスペクト比	4:3
ADC	12 bit
色深度 (カメラ)	12 bit
光学センサークラス	1/3.1"
撮像面積	4.644 mm x 3.492 mm
光学センサーの対角	5.81 mm 1/3.1"
画素サイズ	2.25 µm
CRA (主光線角)	8 °
メーカー	Sony
センサーモデル	IMX900-AQR-C
ゲイン (マスター/RGB)	15.8x/-
AOI 水平	同じフレームレート
AOI 垂直	増加したフレームレート
AOI 画像の幅、ステップ幅	264 / 24
AOI 画像の高さ、ステップ幅	16 / 8
AOI 位置グリッド (水平/垂直)	8 / 8
ピンング水平	-
ピンング垂直	-
ピンング手法	水平: - / 垂直: -
ピンング係数	-
デシメーション (サブサンプリング) 水平	増加したフレームレート
デシメーション (サブサンプリング) 垂直	増加したフレームレート
デシメーション (サブサンプリング) 手法	M/C 自動
デシメーション (サブサンプリング) 係数	2x2



モデル

フレームレートフリーランモード	67 fps
フレームレートトリガー（連続）	70 fps
フレームレートトリガー（最大）	70 fps
露出時間（最小～最大）	0.016 ms - 1999 ms
消費電力	0.5 W - 1 W
画像メモリ	-

環境条件

下記の温度は、デバイス外部の温度を基準としています。

動作時の許容デバイス温度	0 ° C - 55 ° C / 32 ° F - 131 ° F
動作時の許容周囲温度	0 ° C - ° C / 32 ° F - 32 ° F
保管時の許容周囲温度	-20 ° C - 60 ° C / -4 ° F - 140 ° F
湿度（相対湿度、結露なし）	20 % - 80 %

コネクター

インターフェースコネクター	USB 3.0 micro-B、ねじ止め式
I/O コネクター	Wuerth 製 8 ピンコネクター
電源	USB ケーブル

ピン割り当て I/O コネクター

1	電圧出 力 3.3 V
2	接地 (GND)
3	オプトカプラなしのフラッシュ出力 - Line 1
4	オプトカプラなしのトリガー入力 - Line 0
5	汎用入出力 (GPIO) 1 - Line 2
6	汎用入出力 (GPIO) 2 - Line 3
7	接地 (GND)
8	USB 給電:5 V、最大 400 mA

Pin 1



設計

レンズマウント	C-マウントレンズ
保護構造	IP30
外形寸法	29.0 mm x 29.0 mm x 17.0 mm
重量	62 g
ハウジング素材	亜鉛、ニッケルメッキ

Features

オンカメラ画像前処理機能のリスト。

このテーブルのすべての機能は、ホストコンピュータ上で画像の前処理を行うための IDS peak ソフトウェアを介して利用可能です（センサーのモデルによって異なります）。

画像取得

Freerun	✓
Software trigger	✓
Hardware trigger	✓
Trigger controlled exposure	-
Denoiser	-
Long exposure	-
Line scan	-

フラッシュ

Flashing	✓
PWM flashing	-

技術は変更されることがあります (2026-07-13)

ページ 2 の 3

www.ids-imaging.jp

IDS Imaging Development Systems GmbH

Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · E メール apacsales@ids-imaging.com

U3-33D0XCP-C-HQ Rev. 1.2 (1011165)

画像調整

Auto exposure	-
Auto gain	-
Auto whitebalance	-
Color correction	-
Gamma	-
LUT	-
Mirror/flip	X/Y

統合画像処理

Pixel formats	BayerRG8 BayerRG10g40IDS BayerRG12g24IDS
Region of interest	✓
Decimation (FPGA)	-
Decimation (Sensor)	2x2
Binning (FPGA)	-
Binning (Sensor)	

その他

Chunks	-
Sequencer	-
Events	-
Firmware update	✓
1st supported firmware version	3. 62. 25422